



Установка предназначена для работы в режимах внутриобъёмного скрайбирования по технологии «IntraScribe» твёрдых прозрачных материалов, лазерного фрезерования твёрдых прозрачных материалов, а также перфорации и резки по сложному контуру непрозрачных листовых органических и неорганических материалов толщиной до 100 мкм с точностью обработки до 2,5 мкм..

Обрабатываемые материалы: сапфир, кварц, стекла, и другие аморфные и кристаллические прозрачные материалы, а также тонкие (до 100 мкм) непрозрачные материалы, металлы, керамика, полупроводники, органические изоляционные и конструктивные материалы, полиимид, парилен, дүроид и др.

Состав установки:

- Твердотельный лазерный излучатель с диодной накачкой (DPSSL)
- Воздушная система охлаждения линейки лазерных диодов
- Блок питания лазерного излучателя
- Система оптическая сопрягающая с телевизионной камерой
- Осветитель конфокальный
- Осветитель боковой
- Измеритель мощности лазерного излучения
- Блок дополнительного электропитания и управления
- Четырёхкоординатная автоматизированная система позиционирования
- Драйвер управления системой позиционирования
- Столик вакуумный
- Электроуправляемый вакуумный клапан
- Вакуумная арматура
- Блок фильтров-аттенюаторов
- Объектив микроскопический
- Удлинительные кольца
- Столы и арматура

- Приборная консоль и опоры с виброразвязками
- Компьютер управляющий
- Программное обеспечение

Задачи решаемые установкой:

- Скрайбирование вэйферов на сапфировой, стеклянной и пр. основах: +
- фигурная резка тонкого листового материала по произвольному контуру: +
- создание сквозных и несквозных микрорельефов на поверхности прозрачных материалов: +

[Разработчик Установки "Polypher" - ООО "Мултитех "](#)